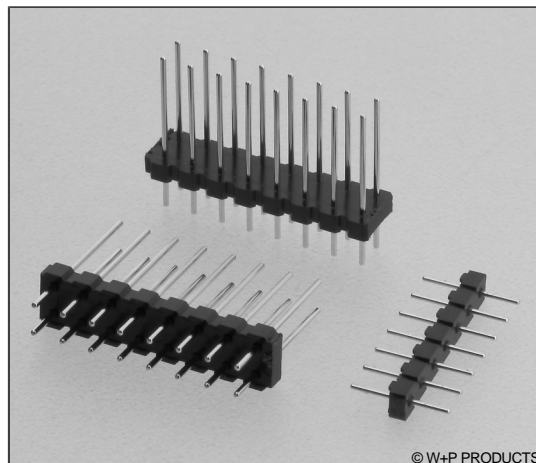


## Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-reihig – Rundkontakte 0,5mm Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Single/Double Row – 0.5mm Round Contacts

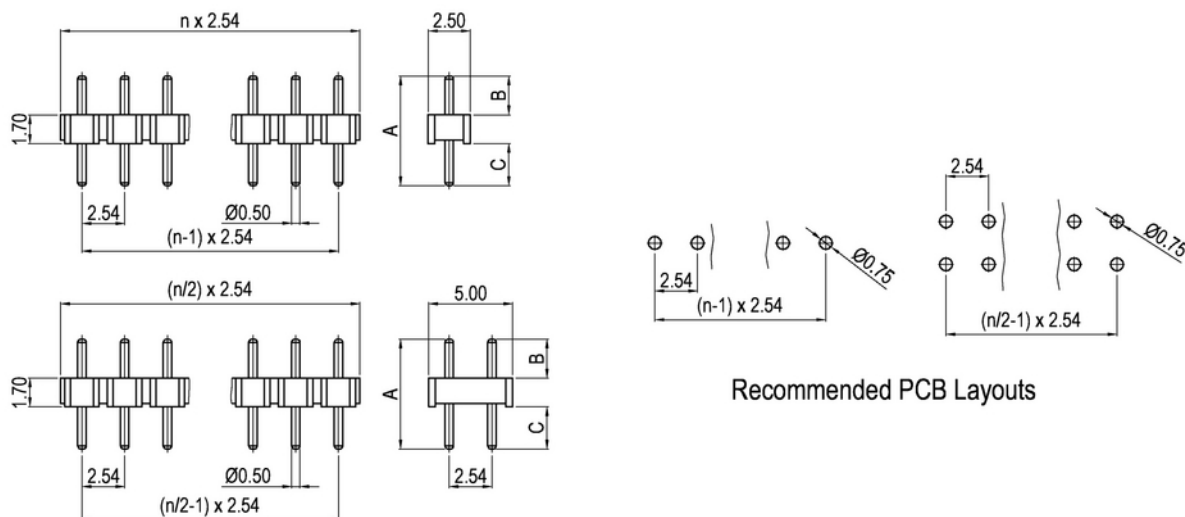
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Rundstift Ø0,50mm, Kupferlegierung <i>Ø0.50mm round pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub> <i>500V<sub>AC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V <sub>AC</sub> <i>250V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +125°C <i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**182 186 256** etc.  
Weitere siehe Kapitel D  
*Please see ch. D for more*



Recommended PCB Layouts

Series	Dimensions*	Contacts*	Type*	Plating*
<b>952</b>	<b>08</b> 08 A=6,50 B=2,30 C=2,50mm 09 A=8,40 B=3,40 C=3,30mm 12 A=11,30 B=6,30 C=3,30mm 13 A=12,60 B=7,60 C=3,30mm 15 A=14,70 B=9,70 C=3,30mm A [mm] Kundenspezifisch (max. 17,0mm) <i>Customer-specific (max. 17,0mm)</i>	<b>040</b> 002-040 Einreihig <i>Single row</i> 004-080 Zweireihig <i>Double row</i>	<b>1</b> 1 Einreihig <i>Single row</i> 2 Zweireihig <i>Double row</i>	<b>00</b> Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i>

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. und Sonderraster sowie weitere Abmessungen auf Anfrage.

*We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5,08mm, 7,62mm, etc. and more pitches as well as more dimensions on request.*

Maximale Stiftlänge: 20mm  
*Maximum Pin Length: 20mm*

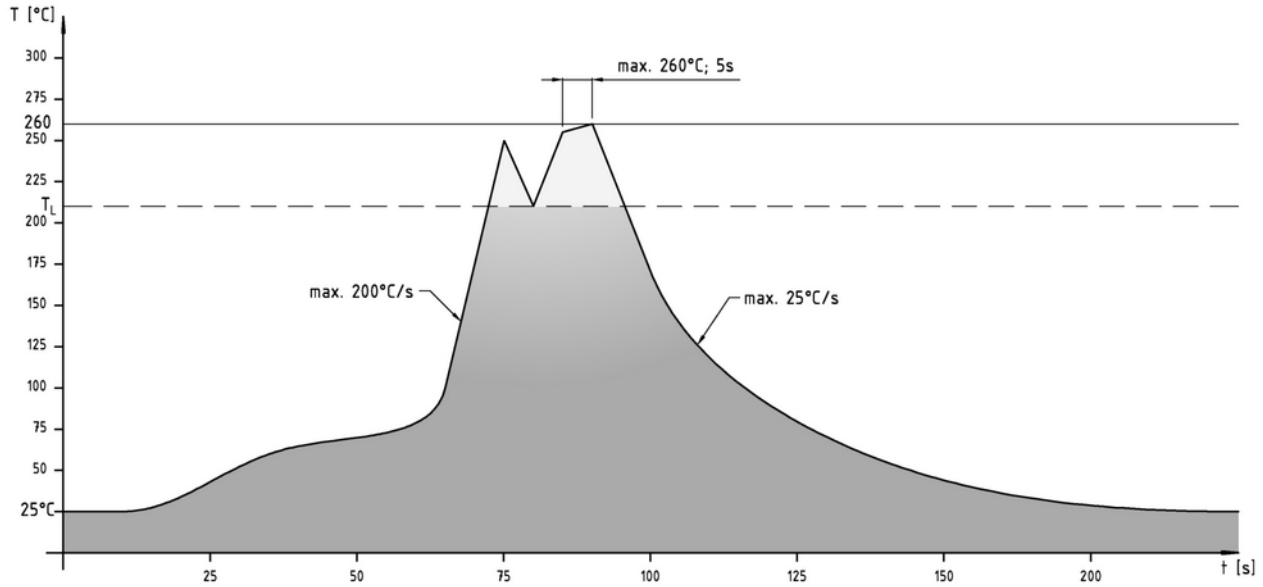
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Lötempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

